

両サイド型スパッタ装置 SP-27000D



厚みのある、あるいは立体的形状の基材へ成膜するために設計された装置です。2基のターゲットを有し、基材を2つのターゲットの間に置いて、両側からの同時成膜が可能です。基材を回転させる事が出来ますので、基材の全長面への成膜が可能です。

両サイド型スパッタ装置 SP-27000D仕様

○到達圧力	×10 ⁻⁵ Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
○排気速度	×10 ⁻⁴ Pa台迄15分以内※常温・無負荷・脱ガス時
○成膜室径	550mmW×550mmD×675mmH SUS304 電解研磨
○スパッタ用電源	DC電源 700V 7KW 1台
○バイアス	DC電源 2000V 2KW 1台
○基板形状	立体物
○膜厚分布	±15%以内
○ターゲット寸法	140mm×270mm(金属)
○ターゲット個数	2
○基板回転	有り
○基板加熱	常温～200℃迄昇温可能
○真空排気系	油回転ポンプ:1300L/sec クライオポンプ:2400L/sec
○操作方法	自動
○ガス系統	マスフローコントローラ 1系統
○ユーティリティ	電気:AC200V三相40KVA 冷却水:30L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環 計装エア:0.5MPa以上 設置寸法:3000mmW×2000mmD×1500mmH